

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年3月29日(2007.3.29)

【公開番号】特開2006-352175(P2006-352175A)

【公開日】平成18年12月28日(2006.12.28)

【年通号数】公開・登録公報2006-051

【出願番号】特願2006-270656(P2006-270656)

【国際特許分類】

H 0 1 L 23/50 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/50 D

【手続補正書】

【提出日】平成19年2月9日(2007.2.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ダイパッドと、

複数のパッドが形成された主面を有し、前記ダイパッド上に搭載された半導体チップと

、

前記半導体チップの周りに配置された複数のインナーリードと、

前記複数のインナーリードのそれぞれに形成されたパラジウム層と、

30 μ m以下の径から成り、前記半導体チップの複数のパッドと前記複数のインナーリードとをそれぞれ電氣的に接続する複数のワイヤと、

前記半導体チップ、前記複数のワイヤ、及び前記複数のインナーリードを封止する樹脂体と、を含み、

前記複数のワイヤの一端部は、前記パラジウム層に接続されていることを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項2】

請求項1において、前記複数のインナーリードとそれぞれ一体に形成されたアウターリードは、前記樹脂体から露出していることを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項3】

請求項1において、前記複数のワイヤの一端部には、圧着部が形成されていることを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項4】

請求項3において、前記圧着部は圧着幅と圧着長を有し、前記圧着幅は前記複数のワイヤの径の1.5倍以上、かつ前記複数のワイヤの径の3.5倍以下であり、前記圧着長は前記複数のワイヤの径の1.5倍以上、かつ前記複数のワイヤの径の3.5倍以下であることを特徴とする半導体集積回路装置。